

2024年3月期 決算 および
新中期経営計画(2024~2026年度)
説明会資料

2024年5月13日
住友バークライト株式会社
代表取締役社長 藤原 一彦



2024年3月期(2023年度)決算概要

2024年3月期 連結業績 (前年との比較)

(金額単位: 億円)

	2023年3月期 実績①	2024年3月期 実績②	前年同期比較	
			金額(②-①)	増減率
売上収益	2,849	2,873	23	0.8%
事業利益	254	275	20	7.9%
営業利益	248	272	24	9.6%
当期利益	203	218	15	7.6%
ROE	8.4%	7.8%	-	-

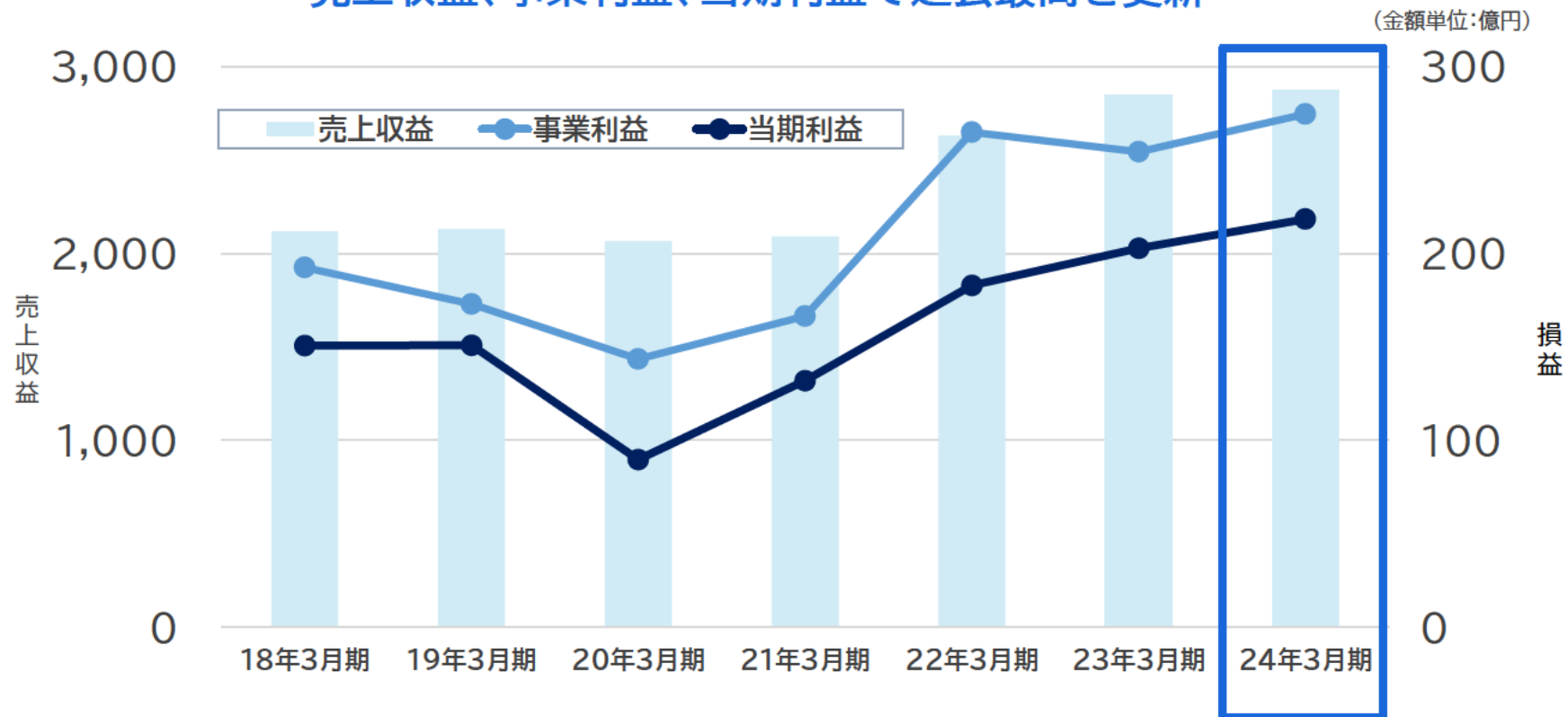
※「事業利益」は「売上収益」から「売上原価」、「販管費及び一般管理費」を控除したベース

「当期利益」は親会社所有者に帰属する当期利益

為替レート	2023年3月期	2024年3月期
USD(\$/¥)	134.95	144.40
EUR(€/¥)	141.24	156.80

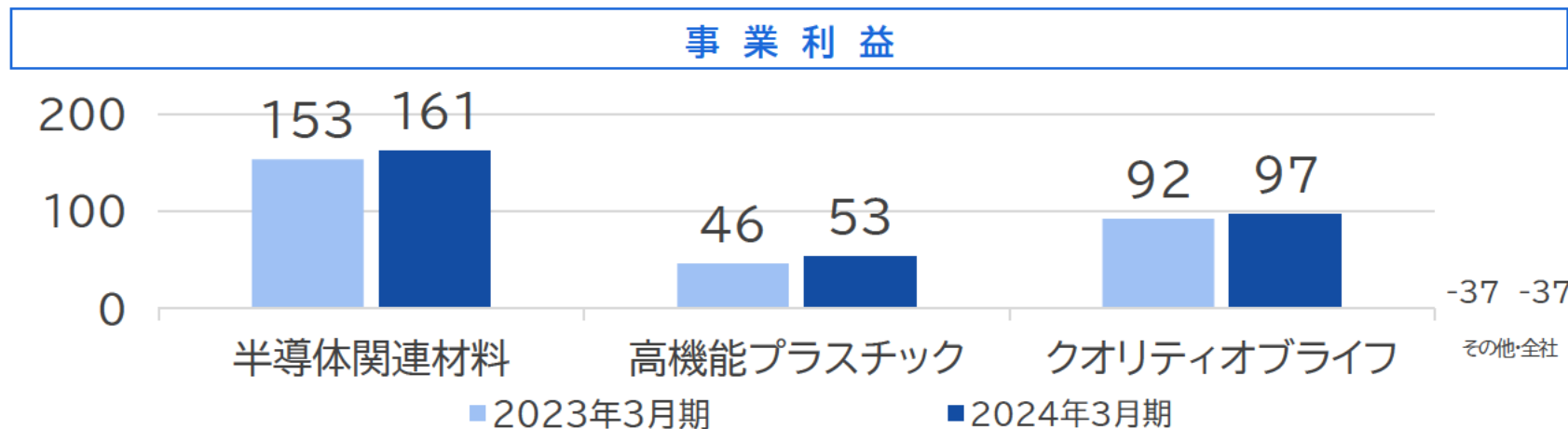
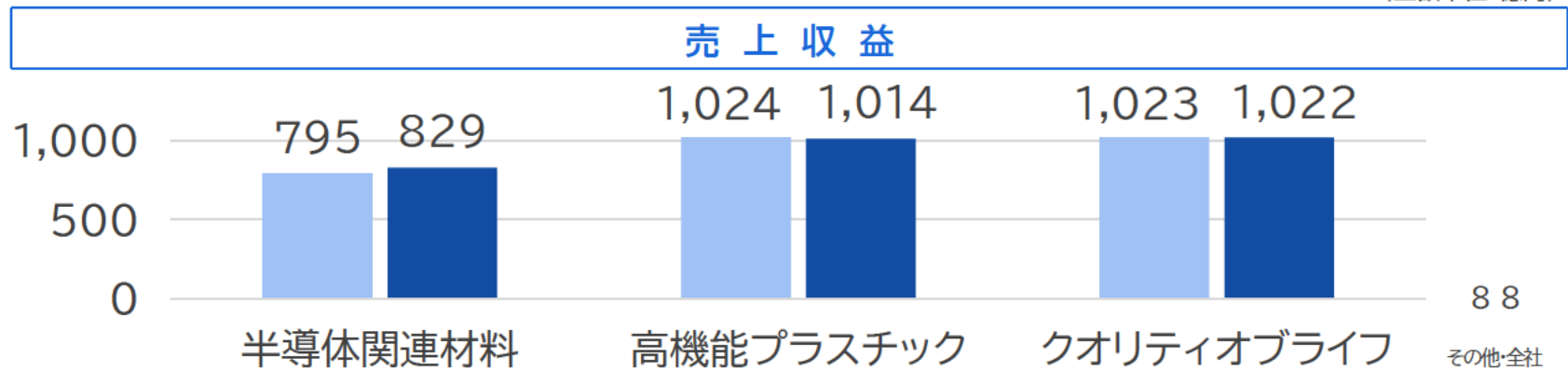
売上収益・損益（年度推移）

売上収益、事業利益、当期利益で過去最高を更新



事業セグメント別業績比較(前年との比較)

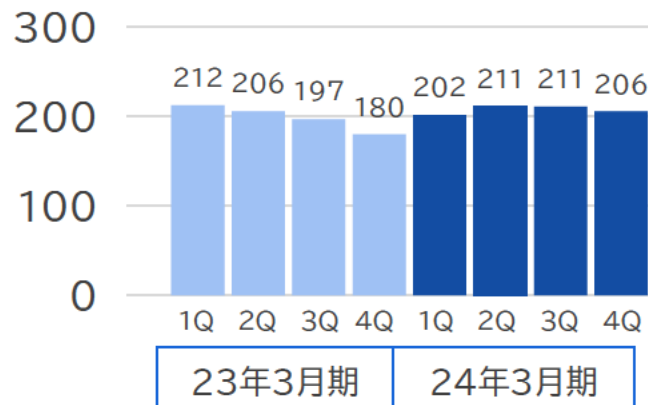
(金額単位:億円)



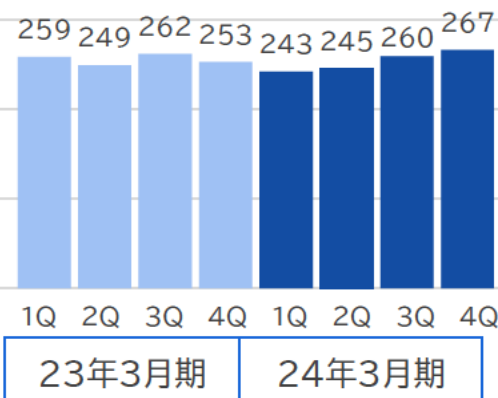
事業セグメント別 四半期販売推移

(金額単位:億円)

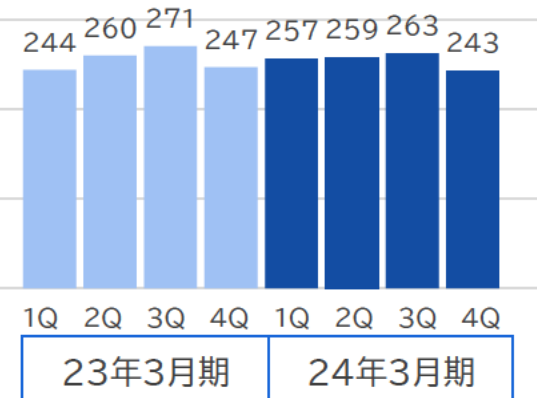
半導体関連材料



高性能プラスチック



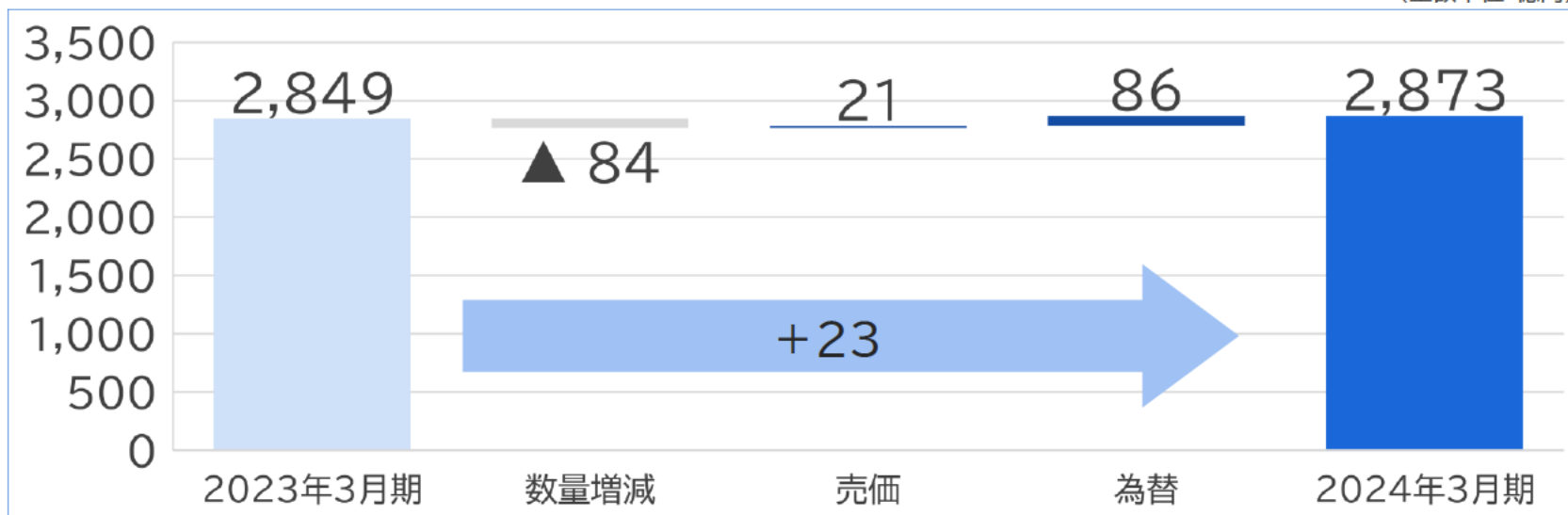
クオリティ オブ ライフ



- 半導体関連材料 : 春節による稼働日減の影響あるが、景況感に変化はない
- 高性能プラスチック : 民生用途の在庫調整が解消し、主にアジアにおいて回復が進んでいる
- クオリティオブライフ : 季節性要因による減少があるが、ヘルスケア関連製品、医薬品包装用フィルム・シートは堅調続く

売上収益増減要因(前年との比較)

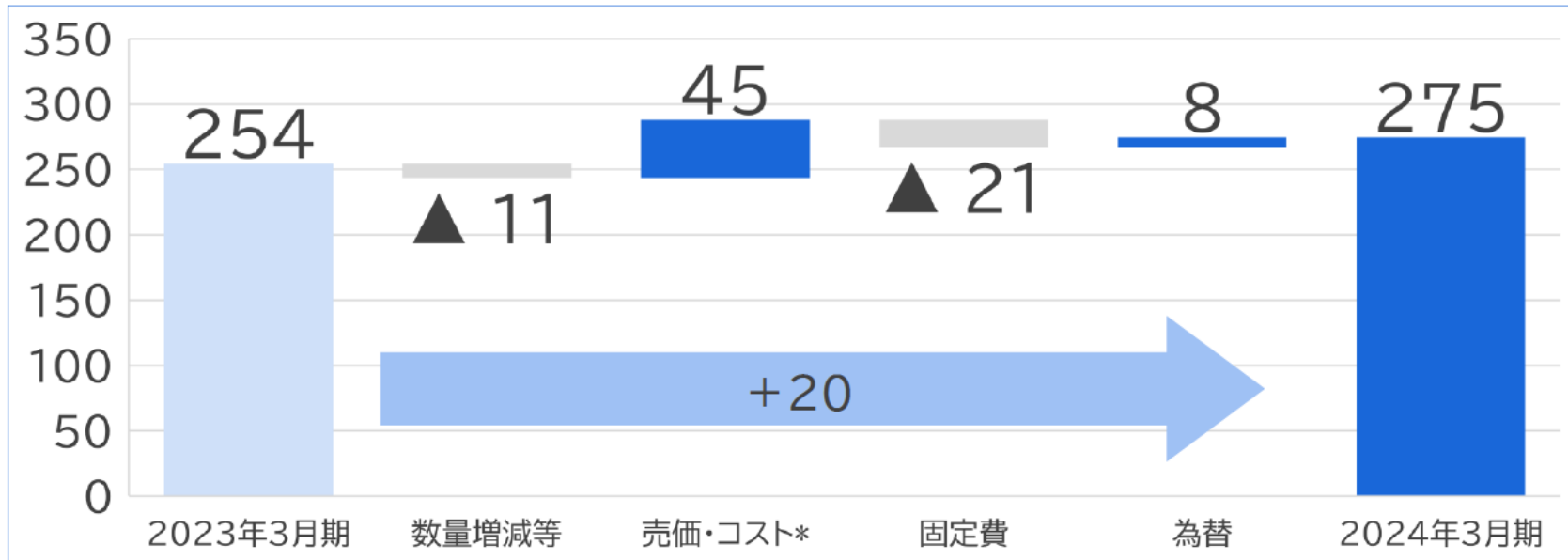
(金額単位:億円)



セグメント別	数量増減	売価	為替	合計
半導体関連材料	5	0	28	34
高機能プラスチック	▲59	▲1	50	▲10
クオリティオブライフ	▲30	21	8	▲1

事業利益増減要因(前年との比較)

(金額単位:億円)



*コストは原料費及びその他変動費の合計

セグメント別	数量増減等	売価・コスト*	固定費	為替	合計
半導体関連材料	21	▲11	▲6	4	8
高機能プラスチック	▲17	36	▲15	2	7
クオリティオブライフ	▲14	20	▲1	1	5
その他	▲1	0	1	0	0



2025年3月期(2024年度) 通期業績予想

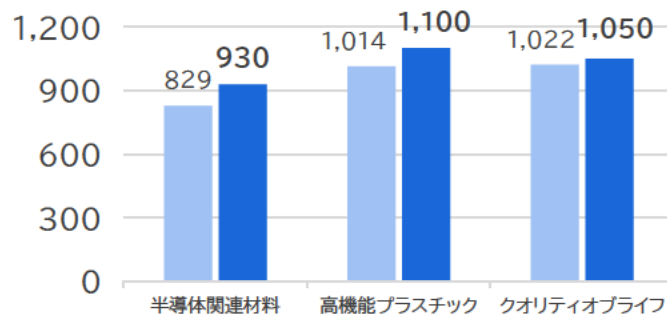
2025年3月期 通期 連結業績予想

(金額単位:億円)

	2024年3月期 実績①	2025年3月期 予想②	前期実績比較	
			金額(②-①)	増減率
売上収益	2,873	3,090	217	7.6%
事業利益	275	300	25	9.3%
当期利益	218	240	22	9.9%

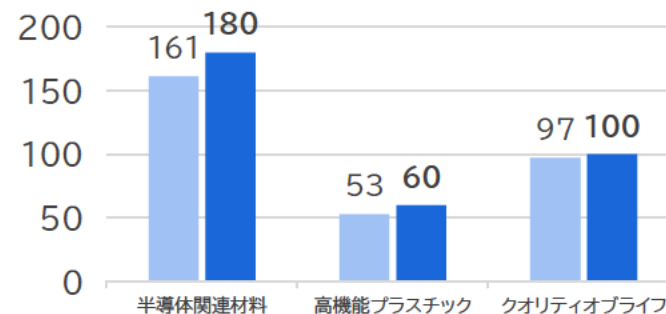
※「事業利益」は「売上収益」から「売上原価」、「販管費及び一般管理費」を控除したベース。「当期利益」は親会社所有者に帰属する当期利益

セグメント別売上収益



2024年3月期実績

セグメント別事業利益

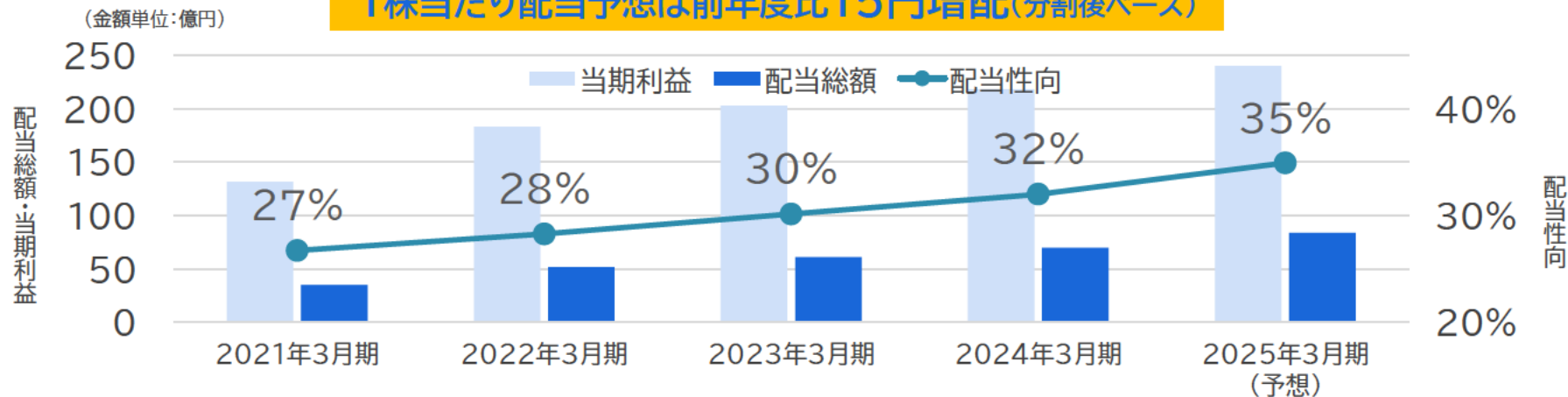


2025年3月期予想

株主還元

■ 配当予想(2025年3月期): 90円/株(中間45円・期末45円)

1株当たり配当予想は前年度比15円増配(分割後ベース)



配当金(円)/株	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	2024年3月期	2025年3月期(予想)	
					分割前ベース (参考)	分割後※ ベース
中間配当	45.00	50.00	60.00	70.00	(90.00)	45.00
期末配当	30.00	60.00	70.00	80.00	(90.00)	45.00
年間配当	75.00	110.00	130.00	150.00	(180.00)	90.00

※2024年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2024年3月期以前は、当該株式分割前の配当額を記載しております。



中期経営計画2024-26 サマリー

中期経営計画2021-23の振り返り

全体

- 当初の財務目標(売上収益2,500億円、事業利益250億円)を中期経営計画初年度に前倒しで達成
- 2023年度は、上方修正した事業利益目標は未達ながら、過去最高益275億円を達成

重点領域(半導体・モビリティ・ヘルスケア)

- 半導体需要増を受け、増産投資を実施。グローバルで迅速に対応し増益達成
- 継続的成長が見込まれるモビリティ用成形材料の増産投資を実施。モビリティ戦略3製品の拡販を計画前倒し
- ヘルスケア領域で買収した川澄化学工業との統合が進展

		2020年度 実績	2021年度 実績	2022年度 実績	2023年度 実績	振り返り
半 導 体	売上収益	573億円	758億円	795億円	829億円	○ 半導体市況需要増に迅速に対応し、シェア拡大 ○ モビリティ戦略3製品の拡販を計画通り実行 ○ 中国/台湾に新ラインを増設(2024年稼働)
	事業利益	94億円	165億円	153億円	161億円	
高 機 能	売上収益	726億円	922億円	1,024億円	1,014億円	× コロナ禍以降の事業環境変化に追従できず、対応に遅れ ○ 放熱材料事業の立ち上げ ○ 航空機事業の黒字化達成
	事業利益	35億円	59億円	46億円	53億円	
Q O L	売上収益	786億円	944億円	1,023億円	1,022億円	○ 医薬品包装フィルムのシェア拡大 ○ 医療機器のグローバルビジネス拡大 ○ 医療機器ベンチャーファンドに出資
	事業利益	66億円	74億円	92億円	97億円	

2030年ありたい姿

策定方針

SDGsに則して、組織一丸となって取り組む目標(財務、非財務)を2030年からバックキャストで設定

経営理念

我が社は、信用を重んじ確実を旨とし、事業を通じて、
社会の進運及び民生の向上に貢献することを期する

パーパス

プラスチックの可能性を広げることで
持続可能な社会を実現する

ビジョン

お客様との価値創造を通じて
「未来に夢を提供する会社」

財務目標

事業利益

550億円

事業利益率

13%

ROE

10%

サステナビリティ推進

2030年ありたい姿の達成に向けて、企業価値の向上と事業基盤の一層の強化に取り組む

経営の重要課題



環境・社会価値の創造

カーボンニュートラルへの取組み
・技術・製品開発 ・GHG排出量削減

資源、創エネ／省エネ、長寿命、3R、環境対策
技術開発の推進

2030年GHG排出量削減目標：
2021年度比 48%削減

SDGs貢献

「6+1」の重点領域を設定し、SDGs貢献を推進
SDGs貢献製品 売上収益比率
2030年度目標：70%

価値創造のアクセラ



顧客との共創



イノベーション



人的資本(人材の活躍)経営



DX

事業を継続する基盤



安全衛生



サイバーセキュリティ



製品責任



人権尊重



コンプライアンス



サステナブル調達



コーポレートガバナンス

中期方針・中期戦略(2024~2026年度)

中期方針

“ニッチ&トップシェア”を目指し、 価値創造につながるポートフォリオ改革に挑戦する

中期戦略①

製品構成を最適化し、
既存事業の収益力を強化

- 利益基準への転換
- 製品ポートフォリオ改革に向けて高付加価値製品へシフト
- SB-ROIC(社内指標)を活用して資本効率性の向上を図る
- 重点領域(半導体/モビリティ/ヘルスケア)にリソースを集中

中期戦略②

SDGsに則した環境的・
社会的価値を有する新商品/
新ソリューションを創出

- SDGs貢献製品の創出
- ニッチ&トップシェアを目指し、カーボンニュートラルを意識した新商品/新ソリューション開発
- 挑戦を全社で支援、提案型テーマの実施をサポート
- 社外との協業強化・仕組みづくり
- 中長期視点で探索領域を設定

中期戦略③

個人の自律性と組織の
一体感を高め、全社力を
最大化

- 人間力向上、従業員エンゲージメント向上を意識した各種取り組みの企画・実行
- 自律性の強化、組織力の向上を目指した教育プログラムの実施
- CS/One Sumibe活動の推進(組織を超えた自主的な連携)

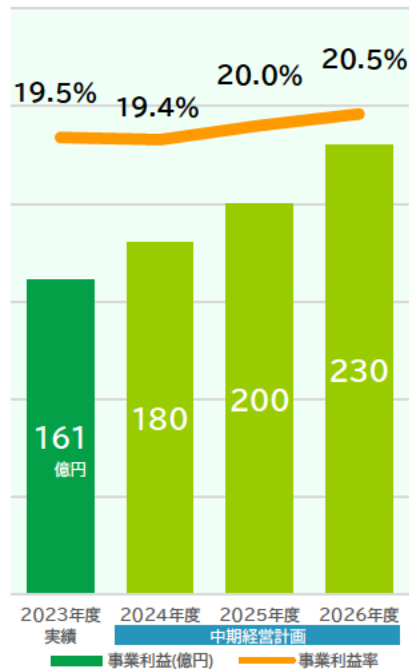
財務目標

資本コストと企業価値を意識した経営に取り組む

中期経営計画2024-26

	2023年度 実績	2024年度	2025年度	2026年度	2030年度 (ありたい姿)
事業利益	275億円	300億円	340億円	400億円	550億円
事業利益率	9.6%	9.7%	10.5%	11.5%	13.0%
(売上収益)	(2,873億円)	(3,090億円)	(3,250億円)	(3,450億円)	(4,200億円)
ROE	7.8%	---	---	9.0%	10.0%

事業戦略～半導体関連材料



現行ラインナップの販売拡大

- 半導体市場回復を見越した封止材のグローバル供給/サポート体制構築

マーケットリーダーとして次世代半導体材料の開発を強化・推進

- HPC^{*1}(チップレット、HBM^{*2})、パワーデバイス用半導体材料(封止材、感光性材料等)
- 環境対応への取組み

社外協業の積極推進

- オープンラボの拡充
- コンソーシアム、アカデミアと協業
- 仮説検証/ソリューション提案力向上

*1 HPC: High Performance Computing
 *2 HBM: High Bandwidth Memory
 *3 RDL: Redistribution Layer



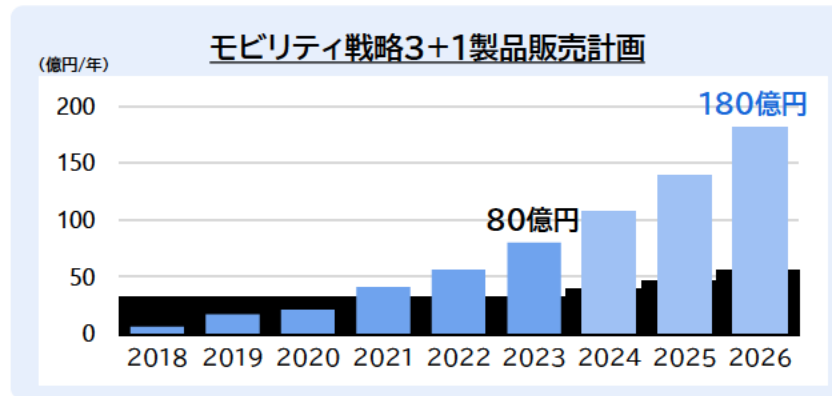
事業戦略～半導体関連材料(モビリティ)

モビリティ戦略3+1製品の販売拡大

- 欧米:「生販研サポート+新生産拠点本格稼働
+オープンラボ拡充」による顧客対応強化・販路拡大

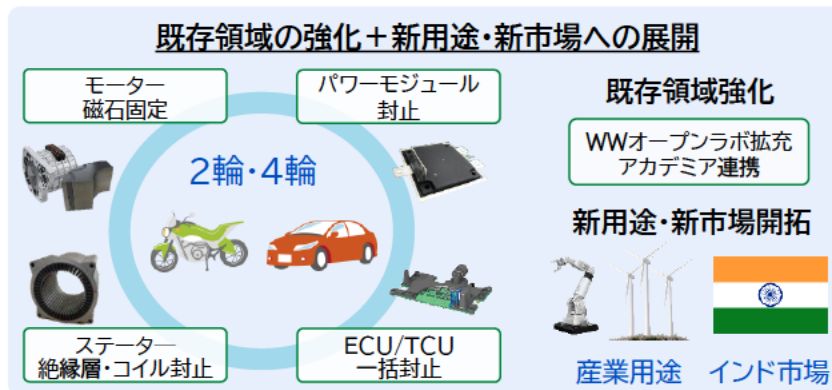


*ECU: Electric Control Unit, TCU: Transmission Control Unit

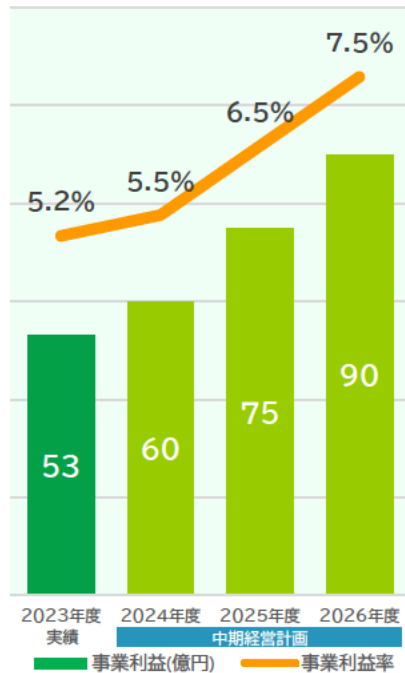


新規用途・新規市場への展開

- 次世代モーター用材料開発
- インジェクション成形用材料の拡大(センサー)
- 2輪4輪eパワートレーンから産業用途へ展開
- インド市場開拓



事業戦略～高機能プラスチック



主なSDGs目標

- 7 エネルギーの持続可能な開発
- 9 産業とイノベーションの持続可能な発展
- 12 つくって、減らす、リサイクル
- 13 気候変動に具体的な対策を

既存領域の収益力強化

- グローバル視点での生産拠点の最適化
- スマートファクトリー化推進による生産性向上

高付加価値製品へのポートフォリオ変革

<強化領域>

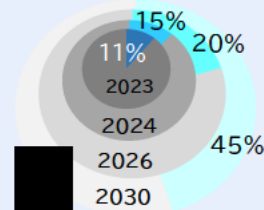
- 電動車(バッテリー、e-Axle、各種電動パーツ)
- 半導体関連(レジスト、パワーモジュール、センサー)
- 航空機(内装材) 等

循環型社会への適応

- バイオマス製品の拡大
- 熱硬化性樹脂リサイクル技術開発の推進

強化領域の製品例

強化領域売上比率

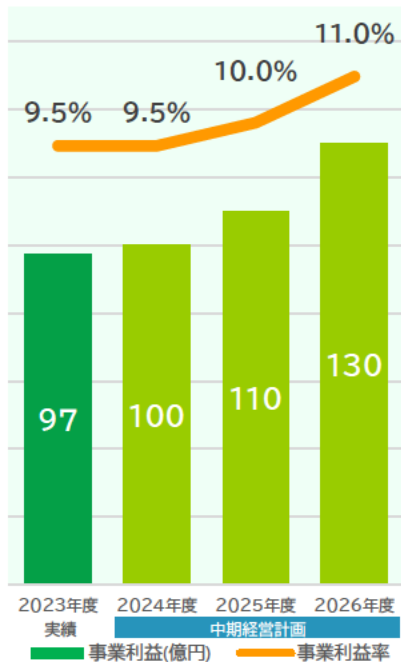


- 液状封止材
- パワーモジュール
- 基板用放熱材
- e-Axle部品
- レジスト用高耐熱樹脂
- バッテリーモジュール部品
- コープライト パネル
- ウインドウリベール アッセンブリ

環境対応製品例

- リグニン変性樹脂
- フラン樹脂
- 各種バイオマス樹脂
- ケミカルリサイクル実証プラント

事業戦略～クオリティ オブ ライフ関連製品



医療機器・バイオ

収益力の強化

- 強化領域(血管内、消化器、内視鏡領域)の製品ラインナップ拡充
- 細胞・遺伝子治療支援製品の拡販
- 不採算製品の整理

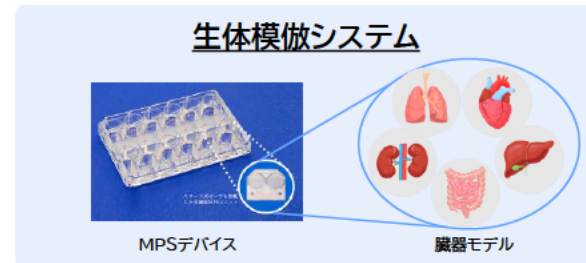
グローバル事業の強化

- 主力製品の海外売上拡大
(欧米:低侵襲医療機器、アジア:血液バッグ等)

バイオ新製品の早期実績化

- 簡便な多臓器連結培養を可能にする創薬支援用生体模倣システム(MPS*)の事業開発

* Microphysiological system



事業戦略～クオリティ オブ ライフ関連製品

フィルム・シート

高シェア製品のグローバル展開

- 半導体用途のアジア展開強化
- モノマテリアルPTPの欧州展開



モノマテリアルPTP

収益力の強化

- スマートファクトリー化推進による生産性向上

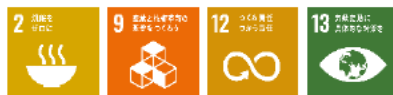
新製品の創出

- 食品ロスの削減に貢献するスキンパックの認知度向上
- 環境対応新製品の上市



スキンパック

主なSDGs目標



産業機能性材料

機能材製品のグローバル展開

- 光学用途(アイウェア、車載)
- 電動車向け絶縁シート



アイウェア製品

新たな付加価値製品の実績化

- 電子調光シートの上市

シート防水

住宅領域での事業強化

- 新築領域シェア*の更なる拡大
- 急増するリフォーム物件の取込み
- 太陽光発電向け防水部材での拡販



太陽光発電向け防水部材

*日本市場シェアNo.1 (当社調べ)

主なSDGs目標



財務目標～セグメント別

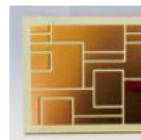
中期経営計画2024-26

		2023年度	2024年度	2025年度	2026年度	主要製品・用途例
半 導 体	事業利益	161億円	180億円	200億円	230億円	 <p>先端半導体 (封止材・感光性材料)</p> <p>パワーモジュール/ECU (封止材・放熱材料)</p>
	事業利益率	19.5%	19.4%	20.0%	20.5%	
	(売上収益)	(829億円)	(930億円)	(1,000億円)	(1,120億円)	
高 機 能	事業利益	53億円	60億円	75億円	90億円	 <p>モーター/バッテリー(成形材料、絶縁材料)</p> <p>航空機内装</p> <p>バイオ由来樹脂</p>
	事業利益率	5.2%	5.5%	6.5%	7.5%	
	(売上収益)	(1,014億円)	(1,100億円)	(1,150億円)	(1,200億円)	
Q O L	事業利益	97億円	100億円	110億円	130億円	 <p>低侵襲医療機器</p> <p>バイオマス・モノマテリアル包材</p> <p>細胞・遺伝子治療支援</p> <p>アイウェア</p> <p>屋根防水</p>
	事業利益率	9.5%	9.5%	10.0%	11.5%	
	(売上収益)	(1,022億円)	(1,050億円)	(1,100億円)	(1,130億円)	

中期戦略② 新商品/新ソリューション創出(中期)

プロジェクトから事業開発部へ

- **放熱材料** (2023年昇格)
高熱伝導フィラーと高信頼性樹脂の配合・生産技術により、信頼性の高い高放熱材料を提供
- **光回路材料** (2024年昇格)
今後様々な用途に適用されていく超高速光通信向け光回路材料を提供
- **MI推進部** (2024年昇格)
データ蓄積・活用、各基盤システム管理・拡張、先進MI技術による全所の課題解決支援や人材育成



現在推進中のプロジェクト

- **e-Axle(電動アクスル)**
熱制御に優れ、小型・軽量・低振動・低騒音等、高効率で省エネ効果の高い電動アクスル提案
- **BMI*ソリューション**
接触抵抗が低く、違和感なく長時間使用可能な樹脂製脳波測定用柔軟ドライ電極を開発
- **電子調光シート**
スイッチの切替で透過率や色彩を自由に調整。アイウェアやスマートグラスなどのメタバース機器用途向けに開発中
- **ケミカルリサイクル技術開発**
循環型社会の実現によるプラスチックとの共生を目指し、熱硬化性樹脂のケミカルリサイクル技術の開発、社会実装に取り組む



*BMI: Brain Machine Interface



※イメージ図

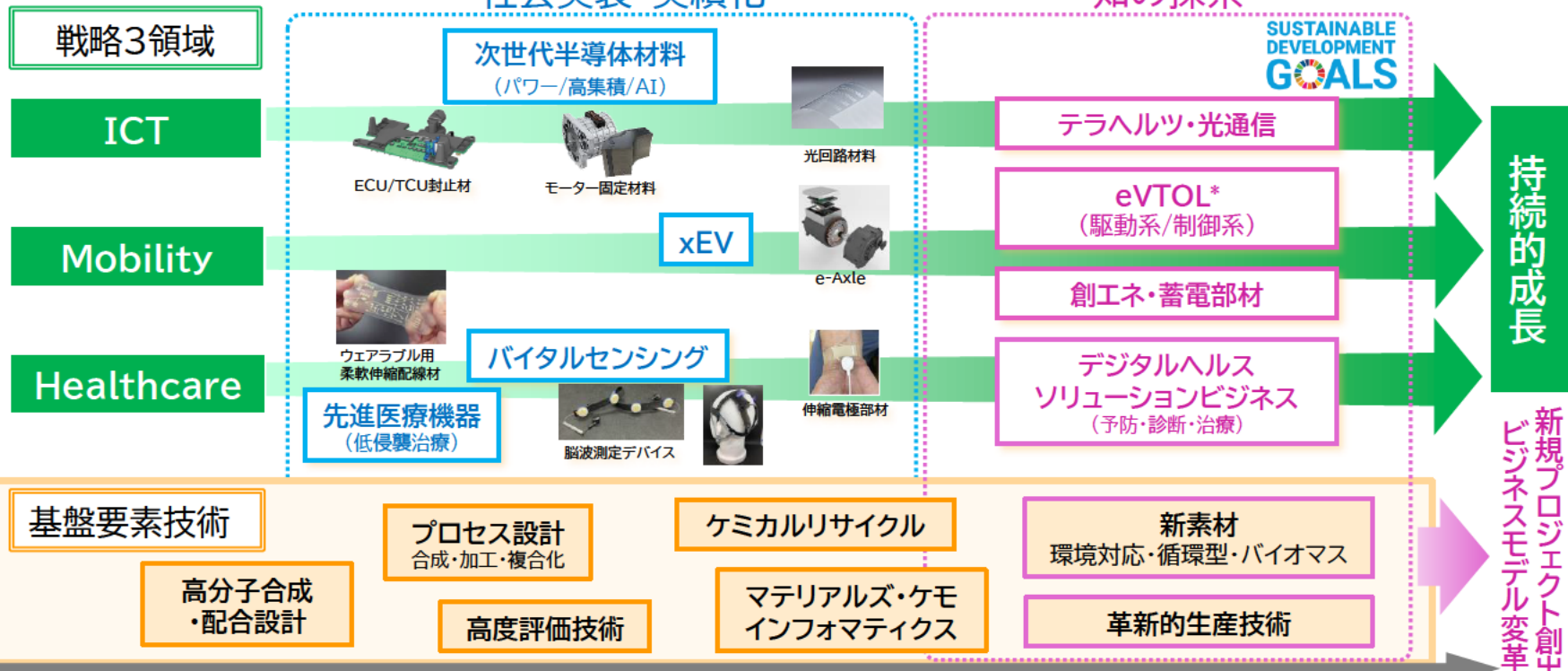


中期戦略② 新商品/新ソリューション創出(中長期)

探索マップ(2024年度版)

社会実装・実績化

知の探索



* eVTOL: Electric Vertical Take Off and Landing aircraft 電気を動力源に、垂直に離着陸できる乗り物(空飛ぶクルマ等)

中期戦略③ 全社力の最大化(人的資本経営)

個人の自律性

挑戦の機会の提供

- 海外トレーニー制
- テーマ創出プログラム



重点取り組み事項

- 女性・キャリア採用者・シニア等多様な人材が活躍できる制度の充実化
- 働き方改革(柔軟な勤務形態)
- 評価制度改革の継続



多様性の尊重



(社内教育システム)



働きやすい職場作り/新たな厚生施設



One Sumibe

組織横断



Customer Satisfaction

組織力の向上

挑戦者を讃える風土醸成

個人の自律性と
組織の一体感を高め、
全社力を最大化

組織の一体感

投資方針・株主還元

「資本コスト」を踏まえて経営資源を配分(2024-26年度)

キャッシュ・アロケーション

設備投資 500億円

成長投資 200億円

戦略的投資 500億円

株主還元 300億円

用途別資金使途見込み

既存事業の収益力強化(中期戦略①)・顧客への安定供給に資する設備投資をタイムリーに実行

新製品/新ソリューション創出(中期戦略②)に向けた研究開発、DX、GX対応を推進

有望案件発掘にむけた知の探索、オープンイノベーション推進、および事業ポートフォリオ改革に資する戦略的M&Aを実行

株主還元方針(2024-26年度)

“安定的かつ継続的に利益を還元する”

配当性向: **40%程度を目指す** (従来目安30%以上から変更)



SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.

<https://www.sumibe.co.jp/>

■ 免責事項について

当社は、本資料の情報がお客様にとって有用なものとなるよう努めておりますが、特定の用途における正確性や妥当性を保証するものではありません。ご利用にあたっては、関連する用途との適合性や安全性を別途ご検証ください。また、本資料に含まれるいかなる事項も、知的財産権等に関する助言や許可を与えるものではありません。

■ 著作権について

本資料の著作権は、特に断りのない限り、当社またその関連会社に帰属します。当社の許可なく、本資料を無断で複製または転用等を行うことを禁止しております。

■ 会社名の表記方法について

本資料における会社名の表記にあたっては、「株式会社」等の表記を省略している場合があります。